4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提出し、かつ、経理責任者が、入札説明書で指定する性能、機能等の要件のうち、必須とした項目にかかる基準を全て満たしている物品を提案したものの中から、経理責任者が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。
⑺　詳細は入札説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kamiike Wataru, Director, National Hospital Organizaiton Kure Medical Center
⑵　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Automatic injection medicine taking out System 1 Set
⑷　Delivery period : March 31, 2010
⑸　Delivery place : National Hospital Organization Kure Medical Center
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
①　not come under Article 5 of the Regulation concerning Contract for National Hospital Organization (NHO). Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause ;
②　not come under Article 6 of the Regulation concerning Contract for NHO ;
③　have Grade A, B or C in "Manufacturers of products" or "Sales of products" for participating in tenders by Ministry of Health, Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Chugoku Region ;
④　prove to have obtained license for selling a medical instrument in accordance with the Pharmaceutical Affairs Law ;
⑤　prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products.
⑥　meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specify in accordance with Article 4 of the Regulation ;
⑺　Time-limit for tender : 5 : 00 P.M. November 27, 2009
⑻　Contact point for the notice : Katsumi Nishihira, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Kure Medical Center, 3—1 Aoyama-cho Kure-shi, Hiroshima-ken 737—0023, Japan. TEL 0823—22—3111 ext. 6310

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成21年10月7日
契約担当職
独立行政法人産業技術総合研究所
調達部長　塩釜　士郎

◎調達機関番号　544　◎所在地番号　08
○産総第67号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等件名及び数量　超微細接続電極用フリップチップ接合装置　1式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　平成22年2月25日
⑸　納入場所　独立行政法人産業技術総合研究所　第二事業所　〒305—8568 茨城県つくば市梅園1－1－1
⑹　入札方法　上記1⑵の件名について、入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2　競争参加資格
⑴　独立行政法人産業技術総合研究所の契約事務取扱要領第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
⑵　独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領により「物品の製造」或いは、「物品の販売」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
⑶　本入札公告の日から開札の時までの期間に独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305—8568 茨城県つくば市梅園1－1－1　独立行政法人産業技術総合研究所　調達部　調達第四室　日向　　洋　電話029—862—6953
⑵　入札説明書の交付期間及び方法
平成21年10月7日から平成21年10月21日まで上記において交付する。
⑶　入札説明会の日時及び場所　平成21年10月14日15時00分　独立行政法人産業技術総合研究所つくば中央第二事業所つくば本部・情報技術共同研究棟　6階　調達部第1入札室L（6308）
⑷　入札書の受領期限　平成21年11月25日17時（郵送による場合は必着のこと。）
ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする。
⑸　開札の日時及び場所　平成21年11月26日15時　独立行政法人産業技術総合研究所つくば中央第二事業所つくば本部・情報技術共同研究棟　6階　調達部第1入札室L（6306）
4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を本公告の3⑷の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当職から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　当研究所において採用できると判断した入札者であって、当研究所の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　詳細は、入札説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Shiro Shiogama Director-Procurement Division for National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Flip-chip bonding machine for ultra-small electrodes 1 set
⑷　Delivery period : February 25, 2010
⑸　Delivery place : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology